

分野・カテゴリ	技術	製品名/シリーズ名	機能・役割
 <p>ウェーハ</p>	<p>X線回折</p>  <hr/> <p>蛍光X線</p>  <hr/> <p>蛍光X線</p> 	<p><a href="#">XRTmicron</a> <a href="#">TFXRD</a> <a href="#">SmartLab</a> <a href="#">FSAS</a></p> <hr/> <p><a href="#">AZX 400</a> <a href="#">WaferX 310</a> など</p> <hr/> <p><a href="#">TXRFシリーズ</a></p>	<p>半導体をX線回折で測定し材料の結晶の状態や品質を調べること、半導体の性能の向上や製造方法の改善につながります。</p> <hr/> <p>半導体製造プロセスにおいて、目的の材料特性を得るため、成膜した膜の塗布量を管理する必要があります。WDXRF（波長分散型蛍光X線分析）は分解能が高く、あらゆる半導体材料の成膜評価を行うことができます。</p> <hr/> <p>半導体製造プロセスにおけるウェーハの汚染は、歩留まりを悪くする要因の一つです。TXRF（全反射蛍光X線分析）シリーズでは、ウェーハの表面を高速に汚染スクリーニングをすることが可能です。</p>
 <p>電子部品</p>	<p>熱分析</p>  <hr/> <p>CT</p>  <hr/> <p>蛍光X線</p> 	<p><a href="#">TG-DTA</a> <a href="#">DSCシリーズ</a> <a href="#">TMA</a></p> <hr/> <p><a href="#">CTLabシリーズ</a></p> <hr/> <p><a href="#">ZSX Primusシリーズ</a> <a href="#">Supermini200</a> <a href="#">EDXシリーズ</a></p>	<p>電子基板に用いられているエポキシ樹脂やセラミックス、鉛フリーはんだなどの熱的特性（融点、膨張率、ガラス転移）を評価するために熱分析装置が用いられています。適切な材料選定や配合、及び製作工程へのフィードバックに役立ちます。</p> <hr/> <p>動かなくなった電化製品の故障原因をつきとめるためには製品を細かく分解、切断する必要がありますが、X線CTでは「非破壊」でその原因を特定、製造工程にフィードバックすることで不良の再発を防ぐことが可能です。製造工程の中にX線CT検査を取り入れることで製品の合否判定に用いられることも増えています。</p> <hr/> <p>電気機器の分野において鉛や水銀などの有害な物質の使用制限しており、製造現場や受け入れ検査で確認が必要です。蛍光X線分析は、これらの有害物質を簡便かつ非破壊で調べることができます。</p>